

溶射装置

○装置の概要

溶射は、熔融状態又は半熔融状態にした材料を高速で吹き付けて、被溶射材に皮膜を形成する手法です。ドライ状態で施工可能で、数 μm ～数mmの皮膜が容易に形成できます。溶射する材料には金属やセラミックなどを利用できます。

この溶射においては、粉体供給装置を用いることで供給粉体を安定して供給できます。また、データロガーにより溶射時の皮膜・基材を含む各部の温度管理を行うことができます。

○主な仕様

<溶射装置>

型式 : Metallisation製MK74
溶射方式 : フレーム溶射法

<粉体供給装置>

型式 : Metallisation製2007MF-PF
ホッパー容量 : 2.8L
供給量 : 1～40g/min
(WA(平均粒子径50 μm)換算)

制御方式 : マスフローメータによるキャリアガス制御
搬送可能粒子径 : 5～60 μm

<データロガー>

型式 : グラフテック(株)GL7000Plus
使用可能熱電対 : K、J、E、T、R、S、B、N、W
チャンネル数 : 10ch/1ユニット
サンプリング間隔 : 10ms/10ch ～1h



JKA Social Action
競輪とオートレースの補助事業

※ 本装置は、技術的課題解決支援事業(有料)による技術指導により、ご利用いただけます。

※ 粉体供給装置及びデータロガーは、公益財団法人JKA「2020年度 公設工業試験研究所等が主体的に取り組む共同研究補助事業」により導入しました。